

# Добро пожаловать в О-ведущую

O-Leading стремится быть вашим партнером по комплексному решению в цепочке поставок EMS, включая разработку печатных плат, изготовление печатных плат и сборку печатных плат (PCBA). Мы предоставляем некоторые из самых передовых технологий печатных плат, в том числе печатные платы HDI, многослойные печатные платы, жесткие гибкие печатные платы. Мы можем поддержать от быстрого прототипа до среднего и массового производства. ([печатная плата печатной платы](#))

В целом, наши клиенты очень впечатлены нашими услугами: быстрое реагирование, конкурентоспособная цена и приверженность качеству. Обеспечение более ценного технического обслуживания и комплексных решений - это путь вперед.

Заглядывая в будущее, компания О-ведущая, как всегда, сосредоточится на инновациях и развитии технологий производства электроники и будет прилагать постоянные усилия для универсального обслуживания печатных плат и печатных плат, чтобы предоставлять первоклассные услуги и повышать ценность для наших клиентов.

ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ЭТО ДЛЯ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ [HDI pcb Печатная плата](#)

## описание продукта

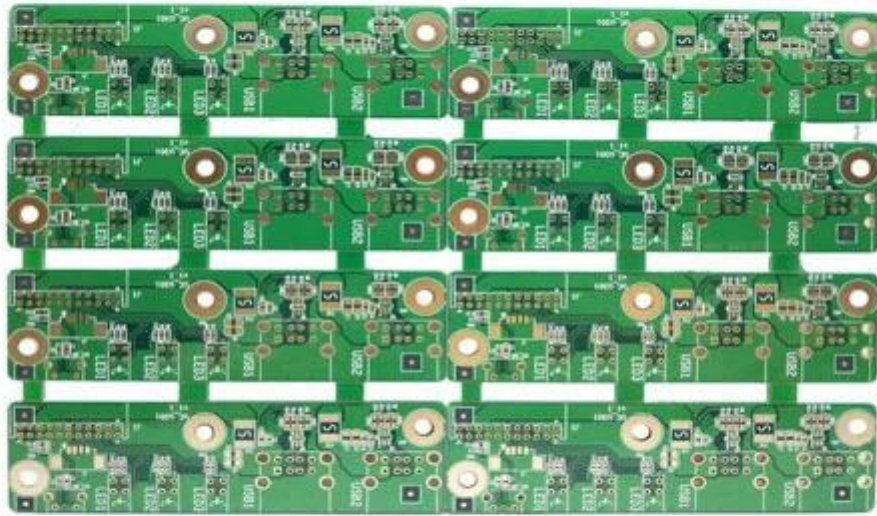
|                          |   |                              |                                      |
|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|
| Место происхождения      | Guangdong Кита (материк)                                      | Имя бренда                   | O-Leading                            |
| Базовый материал         | FR-4, алюминий  | Медная толщина               | 0.5oz-5oz                            |
| Минимум Размер отверстия | 0.2mm   | Минимум Ширина линии         | 0.2mm                                |
| Отделка поверхности      | золото погружения, OSP, бессвинцовый HASL                     | Толщина доски                | 0.1-5mm                              |
| применимый к             | светодиод, мобильный телефон, кондиционеры, стиральные машины | персонаж                     | Промышленный контроль печатной платы |
| сертификаты              | ISO9001, UL, RoHS, SGS  | Q / CTN                      | 10шт-100шт                           |
| вес                      | 0,01 кг -5 кг   | MOQ                          | 10 шт                                |
| Номер модели             | Power Bank PCB Ассамблеи PCBA производитель                   | Минимум Межстрочный интервал | 0.2mm                                |
| цвет                     | синий, красный, зеленый, черный. желтый                       | цена                         | \$ 0.1- \$ 10                        |
| тип design               | требование клиента  | размер                       | 0.01m3-10m3                          |

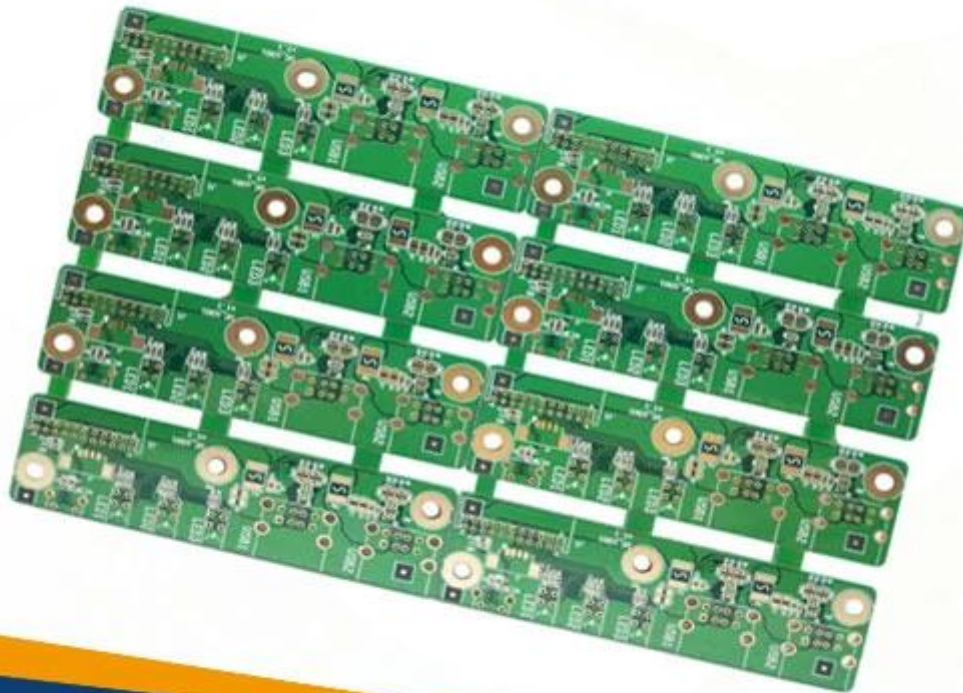
### Возможность производства

### 16 лет профессионального изготовления печатных плат OEM

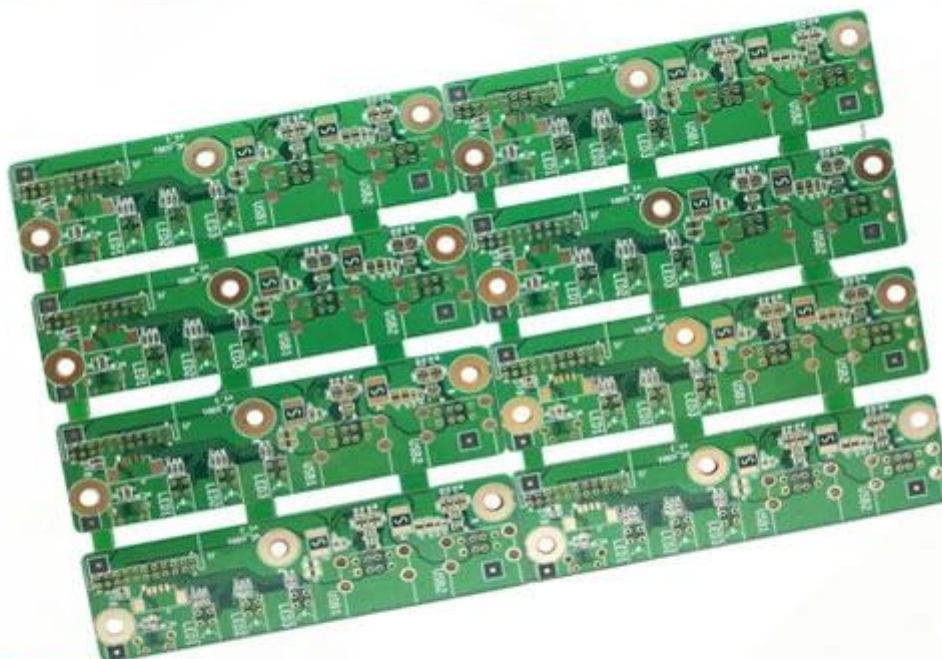
| вещь                             | 2014  |         | 2015 ~ 2016 |         | 2017 ~ 2018 |         |
|----------------------------------|-------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|                                  | объем | Образец | объем       | Образец | объем       | Образец |
| Количество слоев                 | 32    | 42      | 38          | 44      | 42          | 48      |
| Минимальная линия / пробел (мкм) | 50/50 | 40/45   | 40/45       | 40/40   | 35/40       | 35/35   |

|   |   |           |           |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Мин сверлить диаметр (мм)                           | 0,15  | 0,10      | 0,15      | 0,10      | 0,15      | 0,10      |
| Соотношение сторон из ПТГ                           | 14: 1   | 16: 1     | 16: 1     | 18: 1     | 18: 1     | 20: 1     |
| N + C + N,  | 4 + C + 4   | 5 + C + 5 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 |
| Любое соединение слоев                              | 5 + 2 + 5   | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 |
| Заполнение пластины через                           | ДА  | -         | ДА        | -         | ДА        | -         |
| Минимум толщина сердечника (исключая медь) (мкм)    | 50  | 40        | 40        | 30        | 40        | 30        |
| Минимум Диаметр лазерного сверла (мкм)              | 75  | 65        | 65        | 50        | 50        | 40        |
| Виа на похоронен отверстие / сложено через материал | ДА  | -         | ДА        | -         | ДА        | -         |
| Встроенная конденсаторная плата                     | ДА  | -         | ДА        | -         | ДА        | -         |
| Поверхностный процесс                               | Бесвинцовые HASL, ENIG, OSP, Иммерсионное серебро, Иммерсионное олово, Вспышка золота, покрытие золотым пальцем, селективное покрытие из твердого золота, Отрывная паяльная маска, Углеродные чернила |           |           |           |           |           |





**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Китай производитель печатных плат](#)

Наша команда





---

Factory PCB

---



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

---

Factory SMT

---



# Сертификаты







Test Report

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 1 of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO., LIMITED

1313.FLOOR 13, FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : OSP

SGS Job No.: RP19-005089 - SZ
Date of Sample Received: 22 Mar 2019
Testing Period: 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019
Test Requested: Selected test(s) as requested by client.
Test Method: Please refer to next page(s).
Test Results: Please refer to next page(s).

Conclusion: Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

Tina
Tina Fan
Approved Signatory

Red circular seal and disclaimer text for the Chinese branch of SGS-CSTC.

Member of the SGS Group (SGS SA)



Test Report

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 2 of 6

Test Results:

Test Part Description:

Table with columns: Specimen No., SGS Sample ID, Description. Row 1: SN1, SZX19-005304.001, Green"PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected (< MDL)
(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Table with columns: Test Item(s), Limit, Unit, MDL, 0/1. Lists various substances like Cadmium, Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, etc. with their respective limits and detection results.

Red circular seal and disclaimer text for the Chinese branch of SGS-CSTC.

Member of the SGS Group (SGS SA)



# ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

## Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

**O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD**  
 ROOM 1205, 12/F  
 TAI SANG BANK BLDG  
 130-132 DES VOEUS ROAD  
 CENTRAL, HONG KONG

E490354

| Type   | Cond Width    |               | Cond Thk             | SS/ DS/ DSO | Max        | Max    |      | Meets | C     |       |     |   |
|--|---------------|---------------|----------------------|-------------|------------|--------|------|-------|-------|-------|-----|---|
|  | Min           | Edge          |                      |             | Area       | Solder | Oper |       |       | Flame |     |   |
|  | mm(in)        | mm(in)        | mic(mil)             |             | mm(in)     | C      | sec  | C     | Class | UL796 | DSR | I |
| <b>Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.</b> |               |               |                      |             |            |        |      |       |       |       |     |   |
| <b>O-LEADING-401</b>                                     | 0.1 (0.004)   | 0.3 (0.012)   | 34 (1.34)            | DS          | 12.7 (0.5) | 260    | 10   | 130   | V-0   | -     | -   |   |
| <b>O-LEADING-407</b>                                     | 0.08 (0.003)  | 0.2 (0.008)   | 17 (0.67)            | DS          | 9.7 (0.4)  | 260    | 10   | 130   | V-0   | All   | -   |   |
| <b>Multilayer printed wiring boards.</b>                 |               |               |                      |             |            |        |      |       |       |       |     |   |
| <b>O-LEADING-408</b>                                     | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47)<br>Int:136 | DS          | 50.8 (2.0) | 280    | 20   | 130   | V-0   | All   | *   |   |
| <b>Single layer printed wiring boards.</b>               |               |               |                      |             |            |        |      |       |       |       |     |   |
| <b>O-LEADING-002</b>                                     | 0.38 (0.015)  | 1.14 (0.045)  | 34 (1.34)            | SS          | 19.1 (0.8) | 260    | 10   | 105   | V-0   | All   | -   |   |
| <b>O-LEADING-003</b>                                     | 0.38 (0.015)  | 1.14 (0.045)  | 34 (1.34)            | SS          | 19.1 (0.8) | 260    | 10   | 130   | V-0   | ▲     | -   |   |
| <b>O-LEADING-033</b>                                     | 0.15 (0.006)  | 0.3 (0.012)   | 34 (1.34)            | SS          | 25.4 (1.0) | 260    | 10   | 120   | V-0   | All   | -   |   |
| <b>O-LEADING-205</b>                                     | 0.1 (0.004)   | 0.3 (0.012)   | 34 (1.34)            | DS          | 69.6 (2.7) | 260    | 10   | 130   | V-0   | All   | -   |   |
| <b>O-LEADING-206</b>                                     | 0.15 (0.006)  | 0.33 (0.013)  | 17 (0.67)            | DS          | 69.6 (2.7) | 260    | 10   | 130   | V-0   | All   | -   |   |
| <b>O-LEADING-D01</b>                                     | 0.14 (0.006)  | 0.15 (0.006)  | 33 (1.30)            | DS          | 25.4 (1.0) | 260    | 10   | 130   | V-0   | All   | *   |   |
| <b>O-LEADING-S01</b>                                     | 0.25 (0.010)  | 0.25 (0.010)  | 17 (0.67)            | SS          | 25.4 (1.0) | 260    | 4    | 130   | V-0   | All   | *   |   |

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

|                      |              |              |           |    |            |     |   |     |     |     |   |  |
|----------------------|--------------|--------------|-----------|----|------------|-----|---|-----|-----|-----|---|--|
| <b>O-LEADING-S02</b> | 0.2 (0.008)  | 0.2 (0.008)  | 17 (0.67) | SS | 25.4 (1.0) | 260 | 4 | 130 | HB  | ▲   | * |  |
| <b>O-LEADING-S03</b> | 0.25 (0.010) | 0.25 (0.010) | 34 (1.34) | SS | 25.4 (1.0) | 260 | 4 | 130 | V-0 | All | * |  |

\* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所提取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

## Shipping service



| Quick Turn Lead Time |          |                     |
|----------------------|----------|---------------------|
| Layer Count:         | Lead Tim | Special Requirement |
| 1L/2L                | 2-3days  | 24 Hours,48 Hours   |
| 4L                   | 3-4days  | 48 Hours            |
| 6L                   | 4-5days  | 72 Hours            |
| 8L                   | 5-6days  | NA                  |
| 10L                  | 6-7days  | NA                  |
| 12L                  | 7-8days  | NA                  |
| 14L                  | 8-9days  | NA                  |

| Standard Lead Time |                  |                        |
|--------------------|------------------|------------------------|
| Layer Count:       | Sample Lead Time | Volume order lead time |
| 2L                 | 4 days           | 10 days                |
| 4L                 | 5 days           | 11 days                |
| 6L                 | 6 days           | 12 days                |
| 8L                 | 8 days           | 14 days                |
| 10L                | 10 days          | 16 days                |
| 12L                | 12 days          | 18 days                |
| 14L                | 14 days          | 20 days                |
| 16-32L             | 18 days          | 24 days                |

## Возможность процесса

### Возможности производства печатных плат

Количество слоев: 1Layer-32Layer

Толщина готовой меди: 1/3 унции-12 унций

Минимальная ширина линии / расстояние внутри: 3,0 мил / 3,0 мил

Минимальная ширина линии / расстояние между внешними: 4,0 мил / 4,0 мил

Максимальное соотношение сторон: 10: 1

Толщина доски: 0,2 мм-5,0 мм

Максимальный размер панели (дюймов): 635 \* 1500 мм

Минимальный размер просверленного отверстия: 4 мил

Допустимое отверстие в отверстии: +/- 3 мил

Blind / Buried Vias (All Types): ДА

Через заполнение (проводящий, непроводящий): ДА

Материал основания: FR-4, FR-4, высокая Tg. Безгалогеновый материал, Rogers, Алюминиевая основа,полиимида,

Тяжелая медь

Поверхностные покрытия: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, серебро Immersion,олово Immersion, золотые пальцы, чернила углерода



## **Возможности производства SMT**

Материал печатной платы: FR-4, СЕМ-1, СЕМ-3, алюминиевая плата

Максимальный размер печатной платы: 510x460 мм

Минимальный размер печатной платы: 50x50 мм

Толщина печатной платы: 0.5mm-4.5mm

Толщина доски: 0,5-4 мм

Минимальный размер компонентов: 0201

Компонент стандартного размера чипа: 0603 и больше

Максимальная высота компонента: 15 мм

Минимальный шаг подачи: 0,3 мм

Мин BGA шаг шага: 0,4 мм

Точность размещения: +/- 0,03 мм